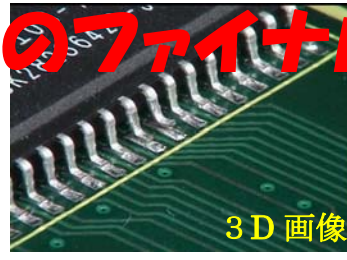


2Dと3Dの両刀づかい！

ハイブリッド卓上型 MODEL 5D 501

5Dチェツカ

実装完了基板のファイナル検査



- ・ 検査データ作成不要の2D検査と3D検査併用の5D検査機です
- ・ 2D・3Dリンク検査は、2D結果を3D画像で確認します
- ・ 2D・3D棲分け検査は、チップ2D検査・リード浮き3D検査
- ・ 精度と感度を上げた、精密な2D部品検査もできます
- ・ 2Dと3Dの単独検査もちろんできます

名称	5Dチェツカ	
型式	ハイブリッドデスクトップ型 5D 501	
検査エンジン	イーグルアイ	リアルスコープ
撮像装置	7500画素カラー1次元CCD	380,000画素カラー 1/4" CCD オートフォー
画像次元	2D	3D 望遠顕微透視
検査解像度	33μm	10μm～
画像倍率(17"モニター)	約22×	23～93×(*デジタルズーム)
照明	高周波点灯白色蛍光灯	
	可動型	固定型
基板サイズ	50mm×50mm～350mm×250mm/T:0.5mm～2mm	
クリアランス	上面:26mm 下面:50mm	上面:120mm 下面:50mm
着脱・幅寄せ	マニュアル操作/外形基準	
コントローラ	PC(WINDOWS™XP)+モニター+キーボード+マウス	
外形寸法(mm)・重量	550(W)×900(D)×700(H); 約90Kg	
電源・消費電力	AC100V 50/60Hz; 1KVA	
動作環境	温度:5～35°C/相対湿度:30～80% (結露がないこと)	
動作モード	①5Dリンク検査・棲分け検査 ②イーグルアイ2D検査 ③リアルスコープ3D検査	
教示方式	基準基板をスキャン(部品はCAD利用可)	検査領域教示
教示時間	約10分(CADデータ利用時)	部品点数比例
検出方式	画素単位の出力差分処理	部品種別認識論理
検出内容	部品搭載不良; はんだ付不良; 基板不良	部品搭載不良; はんだ付不良
対象基板	リフロー前後; クリーム印刷後; 素基板	リフロー後; フロー後
対象部品	はんだクリーム; 表面実装部品	表面実装部品; 挿入部品
検査結果	検出箇所のデータ・画像を実機表示/ズーム画像表示/別置PCに表示(LAN)	
標準検査時間	画像取込み 9s 全面検査 3s/枚 部品検査 5ms/部品 ² ~250ms/視野	

